

证券简称：晶合集成

证券代码：688249

合肥晶合集成电路股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-007

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	国泰基金
会议时间	2023年9月15日
会议地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	朱才伟 董事、董事会秘书、财务负责人、副总经理 黎翠绫 企划协理 曹宗野 证券事务代表
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题 1、请介绍一下公司未来发展规划？ 答复：集成电路产业是支撑国民经济和社会发展的基础性、战略性、先导性产业，集成电路制造又是集成电路产业的核心环节。在当前的国内行业上下游仍高度依赖进口的背景下，公司将抓住 5G、AI、物联网等市场机遇，提升晶圆制造环节的本土企业市场影响力，实现国内显示驱动芯片、微处理器、CMOS 图像传感器等集成电路产品的自主可控供应，进一步提高集成电路行业的国产化水平。未来，公司将不断依托核心优势、提升专业技术水平，整合行业及客户资源，发挥管理团队和技术团队能动性，进一步向兼顾晶圆代工产品和服务能力的综合性晶圆制造企业发展，逐步形成显示驱动、图像传感、微控制器、电源管理四大集成电路特色工艺应用产品线。</p> <p>问题 2、请介绍一下公司生产模式中的生产阶段？ 答复：公司接到客户需求后，首先进行小规模试产；在良率及工艺条件稳定后，进入风险量产阶段；在各项交付指标达标后，与客户签订正式的销售合同或接受批量订单，按照客户需求分配产能、制定生产计划、进行大批量生产。</p>

	<p>问题 3、请问公司对 AR/VR 等新兴应用领域的发展有何布局？</p> <p>答复：公司针对 AR/VR 微型显示技术，正在进行硅基 OLED 技术的开发，已与国内面板领先企业展开深度合作，加速应用落地。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 9 月 19 日